

深圳市银宝山新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	董事、总经理 唐 伟 董事、副总经理、董事会秘书 张海歌 独立董事 兰培珍 独立董事 刘守豹 独立董事 伍晓宇 副总经理、财务负责人 何美琴 参与本次业绩说明会的投资者
时间	2026年5月22日（星期五）15:00-17:00
地点	全景·路演（ http://rs.p5w.net ）
形式	网络远程方式
交流内容及具体问答记录	2025年度业绩说明会互动交流内容如下： 1. 问：请问唐总公司控股股东的股份出售的进展，以及对公 司战略转型的影响？请详细介绍一下唐总大宗交易增持的 基于对公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认 可的具体情况？祝公司成功转型发展，半导体设备业务蒸蒸 日上，成为国际领先的半导体设备公司。 答：尊敬的投资者您好！控股股东公开征集转让股份事项进 展请您以公司公告为准。本人此次用自有资金增持，是基于

对公司核心业务突破与中长期战略落地的坚定信心。将个人利益与公司长远发展绑定，向市场传递了对公司未来发展的看好。感谢您对公司的信任和关注！

2. 问：请唐总详细介绍一下公司生产的哪些产品是供货全球领先的半导体设备制造商 ASMPT SMT 公司，2025 年、2026 年 1 季度营业额占比？介绍一下公司半导体设备的发展规划、发展目标和前景？如何抓住国家半导体、芯片等高端先进制造的历史发展机遇和国产替代机遇、存储芯片超级周期发展机会？如何淘汰落后的低端精密制造，实现向半导体设备先进制造的转型？机会不等人，银宝山新不转型突破就会被历史淘汰、抛弃。

答：尊敬的投资者您好！公司业务情况请您详见公司定期报告“第三节 管理层讨论与分析”“四、主营业务分析”章节。先进半导体装备是公司核心战略方向，公司已将资源高度集中于高附加值的先进半导体装备领域。感谢您对公司战略转型及业务发展的关注与宝贵建议！

3. 问：请问张总公司是否拥有真空封装相关工艺能力，是否具备“真空腔体加工真空封装制程设备真空级精密装配”完整能力的公司？

答：尊敬的投资者您好！暂不具备，感谢您对公司的关注！

4. 问：请问张总公司在光模块制造领域的结构件供应给 ASMPT 公司吗？是否有生产 3D 先进封装设备、光模块制造封装设备的精密结构件产品或技术储备，是否有在进行相关整机设备研发吗？

答：尊敬的投资者您好！相关情况请您详见公司定期报告“第三节 管理层讨论与分析”“三、核心竞争力分析”及“四、主营业务分析”章节。

5. 问：请问唐总目前公司消费电子、新能源汽车、燃油车的精密结构件生产线经改造后，能否转型生产半导体设备的相关精密结构件，以应对半导体设备精密结构件的巨大需求？

答：尊敬的投资者您好！公司具备生产半导体设备的相关精密结构件的能力，公司将结合行业景气度、实际订单情况等，适时地调整产能布局与产品结构，感谢您对公司的关注！

6. 问：请问唐总详细介绍贵公司“以高性能焊线机、固晶机、SMT 印刷机为核心，全线拓展覆盖半导体关键制程的全景产品线”的基本情况。如一是这三种设备在芯片制造设备中的作用（用途）、地位（位置）、价值（是核心设备或缺一不可），核心竞争力；二是这些设备是否具备真空腔体，是否为先进封装设备，请详细说明。2025 年、2026 年 1 季度营业额占比？

答：尊敬的投资者您好！报告期内，公司五金业务销售量及生产量大幅增加，主要系先进半导体装备业务订单需求增加所致。公司核心竞争力请您详见公司定期报告“第三节 管理层讨论与分析 三、核心竞争力分析”章节，感谢您对公司的关注！

7. 问：公司大股东是否有注入资产的可能，公司方向半导体或者机器人等热门领域？

答：尊敬的投资者您好！公司暂无应披露而未披露的重大事项。公司在半导体领域已具备一定的业务基础，目前的战略重心依然是做强做精这一核心主业。公司持续关注智能机器人行业的发展情况，将依托自身在精密模具及结构件领域的制造优势，审慎推进业务的转型升级以寻求新的增长点，感谢您对公司的关注！

8. 问：请问公司2026年一季度归母净利润同比大增188.41%达到1437万元，这个业绩爆发主要靠哪些业务板块拉动，相关业务的发展前景和核心竞争力，市场占有率多少？非经常收益贡献了612万元，这部分收益是可持续的吗？

答：尊敬的投资者您好！2026年第一季度归母净利润同比增加主要系公司高附加值产品占比提升，同时公司持续加强费用管控、提升资源配置与运营效率的结果。非经常损益与主营业务无直接关系，具有偶发性。感谢您对公司的关注！

9. 问：请问贵司的半导体设备处于什么水平？市场认可度如何？目前销售情况如何？为什么没有营收？

答：尊敬的投资者您好！先进半导体装备业务是公司核心业务。公司聚焦于半导体产业链的后道封装与测试环节，以高性能焊线机、固晶机、SMT印刷机为核心产品线，全线拓展覆盖半导体封装全流程的设备产品。目前相关设备已完成交付并获得复购订单，初步验证了产品的技术成熟度与市场认可度。同时，公司作为半导体封装设备主流厂商ASMPT的精密结构件及系统集成供应商，制造能力、质量体系与工艺水平获得客户认可。感谢您对公司的关注！

10. 问：领导，您好！我来自四川大决策 请问，比亚迪、蔚来等新能源车客户的订单增速如何？公司是否已进入一体化压铸供应链？相关产品的认证进展如何？

答：尊敬的投资者您好！公司暂未进入一体化压铸供应链，汽车模具及零部件的业务情况请您详见公司定期报告，感谢您对公司的关注！

11. 问：亲对于未来布局有加速吗？其他国家都在不断提速时不待我啊

答：尊敬的投资者您好！公司经营层持续优化资产及管理结

构，夯实经营基础，同时公司持续关注相关行业发展状况，全力以赴提升企业价值和股东回报。感谢您对公司的关注！

12. 问：公司半导体设备市场拓展情况如何？是否进入头部厂商？

答：尊敬的投资者您好！先进半导体装备业务目前是公司核心业务，相关业务情况请您详见公司定期报告，感谢您对公司的关注！

13. 问：高层对于公司 2026 年度的发展规划是怎么样的？是否有信心保持 2026 年度业绩利润的正增长？

答：尊敬的投资者您好！2026 年度，公司继续积极采取措施来优化运营效率，努力开拓新的市场和客户群体，加强现有产品的竞争力，以提高公司收入和盈利水平。2026 年度业绩情况请您届时关注公司定期报告。感谢！

14. 问：你好，现在所有上市公司都取消监事会，职权下放到审计委员会，独董是怎么理解这一监管规则的变化了的？实际履职有什么变化吗？

答：尊敬的投资者您好！本次变革让我们独董的角色发生了重大变化。随着监事会职权并入审计委员会，我们的监督直接嵌入到了公司的决策链条中。现在的履职要求更高、责任也更重，我们必须运用财务、法律等专业能力，对财务报告、内控及重大交易等重大事项进行实质性审查，坚定维护公司及中小股东的合法权益。感谢您对公司的关注！

15. 问：贵公司以汽车模具和汽车零部件起家，请问贵公司怎么看待汽车行业的发展，如何应对汽车板块业务订单及毛利率下滑风险？

答：您好！汽车模具及零部件行业整体步入成熟期，竞争格

局已由此前的“规模扩张”转向“技术驱动+服务增值”。公司坚定执行“技术驱动、聚焦行业、聚焦客户、聚焦产品”的战略，深化与战略客户的协同开发，并推进智能制造以提升运营韧性与成本优势，确保在产业变革中持续提升市场份额与盈利能力。感谢您对公司的关注！

16. 问：银宝山新何时重组

答：公司目前不存在应披露而未披露的事项，感谢您的关注！

17. 问：请问一下，公司今年能维持一季度的盈利能力么？

答：尊敬的投资者您好！公司会按规定在指定信息披露媒体定期披露公司业绩，敬请关注！

18. 问：公司的城市更新项目工地什么时候开始动工，计划什么时候完工？

答：目前项目正在有序推进中，进展情况请以公司在指定信息披露媒体披露的公告为准，感谢您的关注！

19. 问：这几年都没分红。公司管理层有市值管理与股东回报计划吗？

答：尊敬的投资者您好！公司经营层高度重视市值管理与股东回报工作。近年来，公司持续优化资产及管理结构，聚焦主业夯实经营基础，致力于通过提升核心竞争力来驱动企业内在价值的增长。公司始终将股东回报放在重要位置，感谢您的关注！

20. 问：公司实控人变更为中央汇金后，市场对公司在半导体设备及高端制造的资源配置充满期待。想请问，公司目前在获取地方政府的产业基金支持、或者对接国有大型晶圆厂/封测厂的验证机会方面，相比过去作为民营企业时，是否

感受到了实质性的便利或加速？

答：尊敬的投资者您好！公司实际控制人股权结构变动暨实际控制人变更是按照政府批准的国有股权无偿划转方案执行，不会对公司治理结构及生产经营产生重大影响，感谢您对公司的关注！

21. 问：公司年报提到半导体封装设备及 SMT 印刷机已成功导入供应链。鉴于半导体设备极高的客户壁垒，请问公司目前这几款核心设备的客户复购率大概在什么水平？ 另外，针对一线头部封测大厂，公司目前是仍处于‘送样测试（POC）’阶段，还是已经进入了‘小批量试产’环节？

答：尊敬的投资者您好！公司相关业务情况详见公司定期报告“第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务”章节。感谢您对公司的关注。

22. 问：作为公司重点发力的第二增长曲线，请问半导体设备业务目前的营收规模，是否已经成长到足以对公司整体业绩产生‘实质性影响’的阶段？

答：尊敬的投资者您好！先进半导体装备业务是公司核心业务之一，公司会在指定信息披露媒体定期披露相关信息，感谢您的关注！

23. 问：您好，正月初八的时候，贵司先进半导体 BG 负责人说过「订单喜人，订单已经排到了上半年」，现在已经马上 6 月份，目前之前订单交付状态如何？后续新订单如何？谢谢

答：投资者您好，半导体业务是公司重要板块，相关经营情况请关注公司定期报告，谢谢！

24. 问：公司当前资产负债率处于较高水平，一定程度上侵蚀了企业的抗风险能力。未来在优化资本结构方面，公司除

了依靠经营性现金流改善外，是否会考虑借助上市公司的平台优势，通过引入战略投资者、市场化债转股，或是其他资本市场的融资工具，来从根本上降低负债率、轻装上阵？

答：投资者您好！公司暂无相关计划，感谢您的关注！

25. 问：您好，中东战事，是否有对公司业绩产生消极的影响？公司原材料价格是否上涨？公司与客户的定价体系如何？若原材料上涨，公司是否会告知客户产品涨价？客户是否接受上调价格？

答：尊敬的投资者您好！公司密切关注宏观经济与原材料市场动态。一方面，公司通过内部智能制造升级、工艺改进与精益管理等来持续降本增效，最大程度消化部分成本压力；另一方面，公司密切跟踪市场行情，适时调整原材料采购储备策略，灵活调整经营策略，在保障客户利益的同时，努力提升公司盈利水平，感谢您对公司的关注！

26. 问：您好，公司官网已把原「先进装备制造 BG」分拆为「先进半导体 BG」和「智能机器人 BG」，是否能介绍一下「智能机器人 BG」目前的一些情况？之前也侧面的了解到贵司有和深圳的一些机器人公司有合作，目前合作的状况进展如何？对于智能机器人 BG 公司未来的发展规划是如何？

答：尊敬的投资者您好！公司持续关注智能机器人行业的发展情况，会依托自身在精密模具及结构件领域的制造优势，审慎推进业务的转型升级以寻求新的增长点，感谢您对公司的关注！

27. 问：宝安区石岩城市更新项目目前进展如何，什么时候会收到第三笔补偿吗？

答：尊敬的投资者您好！目前项目正在有序推进中，进展情况请以公司在指定信息披露媒体披露的公告为准，感谢您的

关注！

28. 问：领导您好，注意到公司依托精密制造底蕴，在半导体封装设备等新质生产力领域取得了积极进展，战略转型方向十分清晰。但同时，受宏观环境和行业竞争影响，公司传统主营业务的毛利表现仍面临一定压力，且较高的财务杠杆在一定程度上制约了发展。请问公司管理层，在‘新旧动能转换’的过渡期，针对传统业务的提质增效、以及整体财务结构的优化改善，近期和中长期分别有哪些具体的应对策略和发力点？

答：尊敬的投资者您好！公司将持续推行的“业务聚焦、场地聚焦、人员聚焦”战略，以提升经济效益为核心目标，将持续深耕主业、优化运营效率；公司会持续关注各类再融资工具的适用条件，结合市场环境、监管政策和公司实际发展阶段，优化改善整体债务结构。感谢您的关注！

29. 问：去年股价下降这么多，今年公司会退市么？

答：尊敬的投资者您好！二级市场股价波动受多种因素综合影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；目前公司生产经营情况正常，公司经营指标同比有所向好，不涉及被实施其他风险警示（ST）和退市风险警示（*ST）的情形，感谢您对公司的关注！

30. 问：领导你好，感谢你的回复，既然财务数据要等定期报告，那能否请教一下业务层面的进展？比如目前半导体封装设备（焊线机、固晶机）的在手订单情况如何？今年重点是铺市场，还是已经开始注重盈利优化了？

答：尊敬的投资者您好！公司相关业务在正常推进，具体业务情况请您详见定期报告。2026年度，公司继续集中资源攻坚头部客户，加快战略转型步伐，在开拓市场的同时努力提

升公司的盈利能力。感谢您对公司的关注！

31. 问：您好，据 ASMPT 公司公告说 ASMPT 公司可能会对其 SMT 事业部进行拆分或出售，此举是否会对银宝山新带来不利的影响？除了 ASMPT 公司外，银宝山新是否有和其他半导体公司有合作？进展如何？

答：尊敬的用户您好！感谢您对公司战略发展及客户合作的密切关注。针对您所述的 ASMPT 战略调整事宜，公司不认为会对业务合作产生不利影响。具体业务发展及客户合作情况请您参阅公司的定期报告，谢谢！

32. 问：领导你好，曾注意到智新学院在外面参展时，推出了‘模具工艺大模型’和‘AI 模拟材料成型’这两个很前沿的项目。想直接了解下，目前这两个项目进展如何？

答：尊敬的投资者您好！公司业务及产品情况请您以披露的定期报告为准，感谢您对公司的关注！

33. 问：公司在技术和盈利能力上与行业头部公司的差距在哪里？有没有好的计划？如何解决？

答：尊敬的投资者您好！公司目前仍处于战略转型与结构调整的关键阶段，转型过程中存在阶段性整合成本，当前收入与毛利水平尚在逐步提升过程中。公司围绕“业务聚焦、场地聚焦、人员聚焦”三大方向推进战略转型，紧密围绕汽车模具及零部件、通讯及消费电子、先进半导体装备三轨并进的战略布局，集中资源攻坚优质客户，加快战略转型，全面提升核心竞争力与可持续发展能力。感谢您对公司的关注！

34. 问：作为长期关注公司的投资者，我们非常认可其在半导体封装设备上的新质生产力布局。公司目前在半导体设备/零部件领域，是否已经开始向国内其他‘一线头部晶圆厂

或封测大厂’ 进行送样验证或商务洽谈？

答：尊敬的投资者您好！非常感谢您作为长期投资者对公司的关注与认可。先进半导体装备业务目前是公司核心业务，相关业务情况请您详见公司定期报告，感谢您对公司的关注！

35. 问：请详细介绍贵公司“以高性能焊线机、固晶机、SMT印刷机为核心，全线拓展覆盖半导体关键制程的全景产品线”的基本情况。如一是这三种设备在芯片制造设备中的作用（用途）、地位（位置）、价值（是核心设备或缺一不可），核心竞争力；二是这些设备是否具备真空腔体，是否为先进封装设备，请详细说明。2025年、2026年1季度营业额占比？

答：尊敬的投资者您好！相关情况请您详见公司定期报告“第三节 管理层讨论与分析 三、核心竞争力分析”及“四、主营业务分析”章节。有关业绩情况请您以公司披露的定期报告为准，谢谢！

36. 问：请详细介绍一下公司生产的哪些产品是供货全球领先的半导体设备制造商 ASMPT SMT 公司，2025年、2026年1季度营业额占比？

答：尊敬的投资者您好！公司业务情况请您详见公司定期报告“第三节 管理层讨论与分析 “四、主营业务分析” 章节。2025年度及2026年第一季度的营收情况请您以披露的定期报告为准。感谢您对公司的关注！

37. 问：唐董感谢回复，您说2026年度公司继续集中资源攻坚头部客户，请问头部客户在今年上半年是否有已落地的实质性订单？ 如果有的话，这些订单主要归属于哪个业务板块？

答：尊敬的投资者您好！公司相关业务情况请您以披露的定期报告为准，感谢您对公司的关注！

38. 问：请详细介绍一下公司半导体设备的发展规划、发展目标和前景？如何抓住国家半导体、芯片等高端先进制造的历史发展机遇和国产替代机遇、存储芯片超级周期发展机会？如何淘汰落后的低端精密制造，实现向半导体设备先进制造的转型？机会不等人，银宝山新不转型突破就会被历史淘汰、抛弃。

答：尊敬的投资者您好！非常感谢您对公司发展的思考与宝贵建议！公司持续关注相关行业的发展，会结合市场情况、公司自身竞争优势审慎评估公司战略规划，感谢您对公司的关注！

39. 问：截至今天，股东人数多少？

答：尊敬的投资者您好！请以邮件的方式提供持股证明至 public@silverbasis.com，公司核实后向您提供股东人数信息，谢谢！

40. 问：请问公司 2026 年一季度归母净利润同比大增 188.41%达到 1437 万元，这个业绩爆发主要靠哪些业务板块拉动？非经常收益贡献了 612 万元，这部分收益是可持续的吗？

答：尊敬的投资者您好！2026 年第一季度归母净利润同比增加主要系公司高附加值产品占比提升，同时公司持续加强费用管控、提升资源配置与运营效率的结果。非经常损益与主营业务无直接关系，具有偶发性。感谢您对公司的关注！

41. 问：公司控股股东的股份出售的进展，以及对公司战略转型的影响？请详细介绍一下唐总大宗交易增持的基于对

公司未来持续稳健发展的信心和长期投资价值的认可的具体情况？

答：尊敬的投资者您好！关于控股股东股份出售的进展，公司获悉的有关情况已于 2025 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网《关于控股股东拟通过公开征集一次性转让公司部分股份的进展公告》（公告编号：2025-038）。唐总此次用自有资金增持，是基于对公司核心业务突破与中长期战略落地的坚定信心，将个人利益与公司长远发展深度绑定。感谢您对公司的关注！

42. 问：唐总 您好 请问 2025 年分红怎么样

答：您好！公司 2025 年分红情况详见 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网《深圳市银宝山新科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-026）。感谢您对公司的关注！

43. 问：你好，您回复说到 2026 年第一季度归母净利润同比增加主要系公司高附加值产品占比提升，想请问这个高附加值产品主要是三大核心板块中的哪个板块？

答：尊敬的投资者您好！公司产品比重提升主要集中在模具产品及五金产品。感谢您的关注！

44. 问：公司会并购优质资产吗

答：尊敬的投资者您好！公司暂无应披露而未披露的重大事项，相关事项请以公司披露的公告为准！感谢您对公司的关注！

45. 问：您好，贵司控股 51%的湖南长沙银宝山新公司，目前被列为失信企业名单，公司接下来会对长沙银宝山新公司采取什么措施？是否会对长沙银宝山新公司进行战略切割？

	<p>答：尊敬的投资者您好！长沙子公司目前涉及的失信信息，主要系其与供应商在货款结算方面产生的买卖合同纠纷所致，公司正积极通过法律途径及商业协商等方式妥善处理相关诉讼与债务纠纷，该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。公司将依据规则对相关情况进行披露。公司将进一步加强对公司的风险管控，切实维护公司及全体股东的合法权益。感谢您对公司的关注！</p> <p>46. 问：唐总，鉴于一季报高附加值产品已显著提振利润，请问这主要体现汽车模具及零部件、通讯及消费电子、还是先进半导体装备？公司对半年报延续这一增长势头是否有信心？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！相关业务情况请您以公司披露的定期报告为准，感谢您对公司的关注！</p> <p>47. 问：您好，控股股东上海东兴在 25 年年终总结暨 26 年规划为「一切为了打胜仗」，26 年公司也一直以「打胜仗」为主旨，请问「打胜仗」的定义是什么？对于「打胜仗」公司的标准是什么？谢谢</p> <p>答：尊敬的投资者您好！“打胜仗”的核心定义，就是公司上下凝心聚力，聚焦主责主业，坚决打赢战略转型与高质量发展的攻坚战。对公司而言，“打胜仗”的标准，就是最终通过实实在在的经营成果和业绩增长，来回报广大股东的信任与支持！感谢您对公司的关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应披露重大信息的有关说明。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>